

- d. La cémentation en caisse est un procédé de revêtement par modification de surface ou revêtement par recouvrement, par lequel un substrat est plongé dans un mélange de poudres (caisse) comprenant :
1. les poudres métalliques à déposer (généralement de l'aluminium, du chrome, du silicium ou des combinaisons de ces métaux);
 2. un activant (généralement un sel haloïde); et
 3. une poudre inerte (la plupart du temps de l'alumine).

Le substrat et le mélange de poudres sont placés dans une cornue qui est portée à une température comprise entre 1 030 K (757°C) et 1 375 K (1 102°C) pendant un temps suffisant pour permettre le dépôt du revêtement.

- e. La pulvérisation de plasma est un procédé de revêtement par recouvrement par lequel un canon (chalumeau vaporisateur) produisant et contrôlant un plasma, reçoit des matériaux de revêtement sous forme de poudre ou de fil, les fait fondre et les projette sur un substrat où se forme ainsi un revêtement intégralement adhérent.

La pulvérisation de plasma peut être une pulvérisation à faible pression ou une pulvérisation à grande vitesse effectuée sous l'eau.

N.B.:

1. Par basse pression, on entend une pression inférieure à la pression atmosphérique ambiante.
2. Par grande vitesse, on entend une vitesse du gaz à la sortie du chalumeau supérieure à 750 m/s, calculée à 293 K (20°C) et à une pression de 0,1 MPa.

- f. Le dépôt de barbotine est un procédé de revêtement par modification de surface ou revêtement par recouvrement par lequel une poudre de métal ou de céramique, associée à un liant organique et en suspension dans un liquide, est appliquée à un substrat par pulvérisation, trempage ou étalage. L'ensemble est ensuite séché à l'air ou dans un four puis soumis à un traitement thermique afin d'obtenir le revêtement voulu.

- g. Le dépôt par pulvérisation cathodique est un procédé de revêtement par recouvrement, fondé sur un phénomène de transfert d'énergie cinétique, par lequel des ions positifs sont accélérés par un champ électrique et projetés sur la surface d'une cible (matériau de revêtement). L'énergie cinétique dégagée par le choc des ions est suffisante pour que des atomes de la surface de la cible soient libérés et se déposent sur le substrat placé de façon adéquate.

N.B.:

1. Le tableau ci-dessus se réfère uniquement au dépôt par pulvérisation cathodique par triode, par magnétron ou réactive qui est utilisé pour augmenter l'adhérence du revêtement et la vitesse de dépôt, et au dépôt par pulvérisation cathodique amélioré par radiofréquences, utilisé pour permettre la vaporisation de matériaux de revêtement non métalliques.
2. Des faisceaux ioniques à faible énergie (< 5 keV) peuvent être utilisés pour activer le dépôt.

- h. L'implantation ionique est un procédé de revêtement par modification de surface par lequel l'élément à allier est ionisé, accéléré par un gradient de potentiel et implanté dans la zone superficielle du substrat. Cela comprend les procédés dans lesquels l'implantation ionique est effectuée en même temps que le dépôt en phase vapeur par procédé physique par faisceau d'électrons ou le dépôt par pulvérisation cathodique.

Accord d'interprétation relatif au tableau

Il est entendu que les informations techniques ci-après accompagnant le Tableau des méthodes de dépôt sont destinées à être utilisées le cas échéant.

1. Technologie de prétraitement des substrats énumérés dans le tableau ci-dessus, comme suit :
 - a. paramètres des cycles des bains de nettoyage et de décapage chimique, comme suit :
 1. composition des bains :
 - a. pour éliminer les revêtements anciens ou défectueux, les produits de la corrosion ou les dépôts étrangers;
 - b. pour la préparation des substrats vierges;
 2. durée d'immersion dans les bains;
 3. température des bains;
 4. nombre et séquence des cycles de lavage;
 - b. critères visuels et macroscopiques d'acceptation de la pièce nettoyée;

- c. paramètres du cycle de traitement thermique, comme suit :

1. paramètres de l'atmosphère, comme suit :
 - a. composition de l'atmosphère;
 - b. pression de l'atmosphère;
2. température du traitement thermique;
3. durée du traitement thermique;

- d. paramètres de préparation de la surface du substrat, comme suit :

1. paramètres de sablage, comme suit :
 - a. composition du sable;
 - b. taille et forme des grains de sable;
 - c. vitesse de projection du sable;
2. durée et séquence du cycle de nettoyage après sablage;
3. paramètres de finition de surface;

- e. paramètres des techniques de masquage, comme suit :

1. matériau du masque;
2. emplacement du masque.

2. Technologie afférente aux méthodes d'assurance de qualité in situ pour l'évaluation des procédés de revêtement énumérés dans le tableau ci-dessus, comme suit :

- a. paramètres de l'atmosphère, comme suit :

1. composition de l'atmosphère;
2. pression de l'atmosphère;

- b. paramètres de temps;

- c. paramètres de température;

- d. paramètres d'épaisseur;

- e. paramètres d'indice de réfraction.

3. Technologie afférente aux traitements après dépôt des substrats revêtus énumérés dans le tableau ci-dessus, comme suit :

- a. paramètres de grenailage, comme suit :

1. composition de la grenaille;
2. taille de la grenaille;
3. vitesse de projection de la grenaille;

- b. paramètres de nettoyage après grenailage;

- c. paramètres du cycle de traitement thermique, comme suit :

1. paramètres de l'atmosphère, comme suit :
 - a. composition de l'atmosphère;
 - b. pression de l'atmosphère;
2. cycles temps-température;

- d. critères visuels et macroscopiques après traitement thermique pour l'acceptation du substrat revêtu.

4. Technologie afférente aux méthodes d'assurance de qualité pour évaluation des substrats revêtus énumérés dans le tableau ci-dessus, comme suit :

- a. critères d'échantillonnage statistique;

- b. critères microscopiques pour :

1. l'agrandissement;
2. l'uniformité de l'épaisseur du revêtement;
3. l'intégrité du revêtement;
4. la composition du revêtement;
5. la liaison entre le revêtement et les substrats;
6. la régularité de la microstructure;

- c. critères pour l'évaluation des propriétés optiques :

1. réflectance;
2. transmission;
3. absorption;
4. dispersion.

5. Technologie et paramètres relatifs aux procédés spécifiques de revêtement et de modification de surface énumérés dans le tableau ci-dessus, comme suit :

- a. pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique :

1. composition et formule de la source du revêtement;
2. composition du gaz porteur;
3. température du substrat;
4. cycles temps-température-pression;
5. contrôle du gaz et manipulation de la pièce;

- b. pour le dépôt en phase vapeur par procédé physique par évaporation thermique :

1. composition du lingot ou de la source du matériau de revêtement;
2. température du substrat;
3. composition du gaz réactif;
4. vitesse d'avance du lingot ou vitesse de vaporisation du matériau;
5. cycles temps-température-pression;
6. manipulation du faisceau et de la pièce;